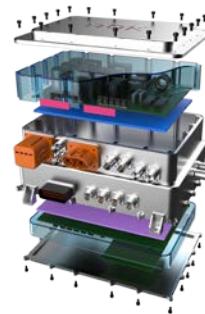


双组份导热灌封胶

GF200是一款低粘度高效导热有机硅双组份灌封胶，导热系数2.0W/(m·K)，分为AB组分，按照1:1混合，混合均匀后能自排泡和常温固化，固化后具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果，可用于发热电子元件的导热封装。



特性和优点

- 导热系数2.0W/(m·K)
- 操作时间可调
- 高电气绝缘
- 流动性、浸润性好
- 可实现自动化作业

典型应用

- OBC, DC-DC, 连接器, 传感器, 放大器等
- LED, 电源, 功率转换器, 变压器, 高压电阻器

***操作时间：**混合后，在操作时间内使用完毕

典型属性

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色(A/B)	粉色/白色	目视
粘度(mPa·s)	part A: 6,000±1,000 part B: 6,000±1,000	ASTM D2196 @6号转子/转速100rpm
操作时间(min) @25°C	60~90	A/B按1:1混合后在一起粘度上升到初始值两倍的时间
固化时间 (h) @25°C (min) @90±5°C	<8 ≤15	A/B按1:1混合后
流平性(mm)	≥100	@20mL/5min
固化后		
密度(g/cc)	2.4±0.2	ASTM D792
硬度(Shore 00)	50±10	ASTM D2240
拉伸强度(MPa)	≥0.05	ASTM D412
断裂伸长率(%)	≥30	ASTM D412
撕裂强度(N/mm)	≥0.1	ASTM D624
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	6	温度<40°C密封储存、避免暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥7.0	ASTM D149
介电常数 @1MHz	5±1	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	≥10 ¹¹	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	2.0±0.2	ISO 22007-2
热膨胀系数(ppm/°C) @-40~150°C	120±15	ASTM E831-2014